注意事项：（不符合不能提交）Note：（Can't meet,Can't submit!）

1.此表内容涵盖我司对元器件可组装性的基本要求，请如实认真填写；

This table covered all the basic assembly requirement of the components in our company，please fill the truth。

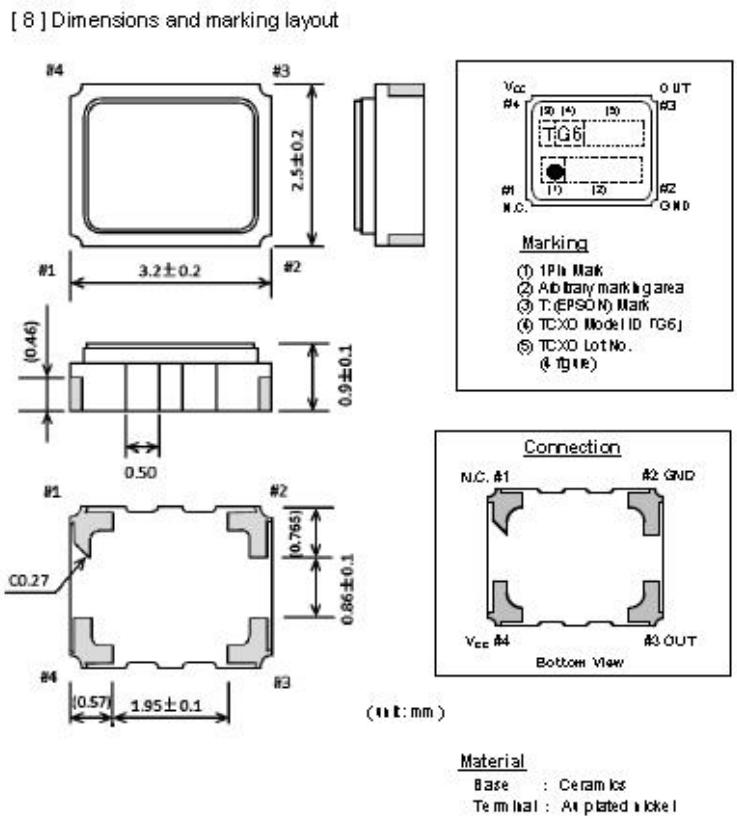
2.进行元器件认证时，请供应商反馈必填信息，不反馈或反馈不全将不能通过工艺审核；

In component certification，please ask the supplier feedback the information as required，there's no feedback or incomplete will be unable to pass。

3.如有特殊情况需要我司注意的，请如实反馈在对应栏目或表尾"其它"中。

If there's special situation that need us to pay attention，please fill the truth in the corresponding column or the table end。

品牌 Brand： **物料名称 Name：** **器件型号 DeviceType：**

工艺大类	工艺小类	工艺次小类	填写内容
元器件封装 Package	封装遵循的国际标准 Package standard	a.、EIA； b、IEC； c、JEDEC； d、EIAJ； e、其它 other__。	
	是否无铅 Lead or lead free	a、有铅 leaded； b、无铅 leadfree； c、Rohs	
	封装尺寸和形状 Package type and size(S M D 7 . 0 * 5 . 0 m m)		
	表贴元器件 SMD/SMC （回流填）	引脚特征 Lead fatures(g)	a. 翼型 gull –well b. J 型 J-shape c. 面阵列球型 BGA d. 面阵列矩形 CCGA（expQFN） e. 焊接端子 termination

<以上所有信息均为 xxx 有限公司所有，不得外传>
All Rights reserved, No Spreading without Permission of xxx

			f. 绕线端子 wrap termination g. 其它 other NiAuPlatform	
		引脚间距(mm) Lead pitch	2.235/1.242mm	
		引脚共面度（多引脚） Lead coplanarity(mm)	0.1mm	
	插装元器件 THD （波峰填）	引脚间距 Pitch(mm)	Not applicable	
		间距公差(mm) Potch Tolorance	Not applicable	
	压接元器件 Crimp Contact （压接填）	引脚间距(mm) Pitch	Not applicable	
		引脚刚弹性 Pin rigid	A 刚性 rigid B 弹性 flexible	
元器件用于焊接的引脚/端子材料 Lead/2ermination material for soldering	引脚基体材料 Lead Lead Frame Material*(B)*	A 铜 Cu; B 陶瓷 Ceramics; C 其他 Other_Ni Au _		
	引脚/端子镀层材料 Lead/termination surface plating/coating material （回流/波峰/手工填）	表面镀层 Surface plating/coating material	材料成分*(a)* composition	**aNiAu;**bNiPdAu;cNiPd;Sn;eSnAgCu;fSnBi;gSnCu.H 其
			厚度*(*)* Thickness	Au:0.3-1.0um
			制作工艺*(a)* Plating/coating process	a 直接电镀 plating b 电镀后回流熔融 reflow melt after electric plating c 热浸方式 dip into solder d 其它 other___ 若是 d，请注明具体工艺。 若为 BGA,选 D，并列出焊料球的信息。 If chose D，pls fill the blank； If BGA，pls chose D,and fill the material of ball in the blank。
		阻挡层/中间层 Barrier/inter mediate layer*(A)*	材料成分 Composition	A. 镍 Ni；B 铜 Cu； C 其它 Other__
			厚度 Thickness	Ni:1.27-8.89um
	可焊性*(A)* Solderability	A 可以满足 IPC J-STD-002C 标准的焊槽浸润法，连续焊料涂层面积达总浸锡面积的 95%以上； Can meet the IPC J-STD-002C， B 不能满足此标准要求。		
组装工艺 Assembly process	推荐的焊接方法 Soldering method *(A)*	A. 回流焊接(Reflow Soldering) B. 波峰焊接（Wave Soldering） C. 手工焊接（Hand Soldering）		

<以上所有信息均为 xxx 有限公司所有，不得外传>
All Rights reserved, No Spreading without Permission of xxx

	（可多选 Multiple Choice）	D. 压接（Press Fit） E. 其它 Other_____		
	回流焊焊接参数 Reflow soldering process parameters （回流填）	最高温度（℃）（回流炉温度）（Tp） Peak temperature	**260** ℃	
		最高温度下的焊接时间（s） soldering time under peak temperature	**5 s**	
	高温耐热性 Resistance heating （按照能承受的最大温度、时间选择填写）*(A)*	是否温度敏感性元器件？ 是 Yes□ 否 No■ Temperature sensitive?		
		表贴元器件整体能否承受以下要求，并保持电、机械性能正常： Can the body of SMD/SMC receive the conditions： A.260℃，10s？ B.260℃，5s？ C.260℃，__s D 其它 Other____		
		插装元器件引脚能否承受以下要求，并保持电、机械性能正常： Can the foot of THD/THC receive the conditions： A.350℃，10s？ B.350℃，5s？ C.350℃，__s D 其它 Other____		
	返修温度、时间 Repair temperature and time	能否承受温度：340℃±20℃，时间：不少于 5s 的返修要求？ Can the THD/THC/SMD receive the repair conditions：340℃±20℃，5s？ 是 ■ 否 □ Yes ■ No □		
	能承受的正常焊接次数*(D)* Maximum soldering times	A 可承受 5 次以上，正常的回流焊或波峰焊；(5times nomal solering) B 可承受 4 次，正常的回流焊或波峰焊；(4times nomal solering) C 可承受 3 次，正常的回流焊或波峰焊；(3times nomal solering) D 可承受小于 3 次，正常的回流焊或波峰焊。(less than 3times nomal solering)		
	推荐的散热方式 Recommendation heat sink mode	No		
元器件包装 packing	表贴元器件包装类型*(A)* （回流填）	A 卷带式 Tape	前端无元器件长度 Length of Front-end no component	150mm min
			后端无元器件长度 Length of Back-end no component	150mm min
		B 管式 Tube	管装尺寸 Tube Size	
		C 盘式 Tray	托盘尺寸 Tray Size	
		D 散装 Bulk		
		E 其他 Other		
		说明请在选项前划 √，若选其它，请写明具体工艺。 Choose the Package type with √,if chose E，pls fill the blank。		

<以上所有信息均为 xxx 有限公司所有，不得外传>
All Rights reserved, No Spreading without Permission of xxx

	插装/压接元器件包装类型 Packing type for THD(*)（插装/压接填）	A 编带包装 Tape C 盘装 Tray E 散装 Bulk	B 管装 Tube D 插泡沫包装 Insert Foam Package F 其它 Other
存储要求 Storage requirment	运输和存储环境条件	相对湿度(%RH) Relative humidity	25%~85%
		温度(℃) Temperature	+15℃~+35℃
	可存储期限(月) Maxinum storage time(*)	12 months	
潮湿敏感元器件 Moisture sensitive device MSD	潮湿敏感等级(*) MSL	2A	
	包装防潮性能 Packing requirement	包装袋 Packing bag	是否防潮 Moisture barrier bag? Yes■ No□
		干燥材料 Desiccant	是否置于包装袋内 in MBB? Yes■ No□
		警告标签 Warning label	是否贴在包装袋 on the MBB surface? Yes■
	潮湿敏感元器件烘烤要求 Requirment for MSD	A 元器件可承受烘烤要求：125℃，24 小时， Baking requirement for tape and tray：125℃，24hours； B 元器件可承受烘烤要求：45℃，192 小时， Baking requirement for tape and tray：45℃，192hours； C 其它 Other_No need___	
	信息资料 Information requirement	受潮后的处理方法 Baking method after absorbing moisture	A 烘干 Drying; B 废弃 Discard; C 其它 Other
		注意事项 caution when used	请联系厂家确认是否有性能问题
防静电 ESD	静电敏感等级 ESD level	**Class2**	
	元器件静电敏感电压 V（放电电压） Electrostatic sensitive volt	■人体模型 HBM	**2000V**
		□带电器件失效模型 CDM	
		□其它模型 Other model_____	
	特殊防静电元器件 Particular ESD	如有特殊的防静电要求，请填写。 If particular ESD，please fill the form。	
焊后清洗和涂覆 Clean and	清洗和涂覆信息 Clean and information	能否进行清洗和涂覆？ Can the compnents and device clean or coat? 是/Yes □ 否/No ■	

<以上所有信息均为 xxx 有限公司所有，不得外传>
All Rights reserved, No Spreading without Permission of xxx

coating	清洗方式，要求 Clean method Requirement	
	可使用的涂覆材料 Used coating material	能否用聚氨酯和有机硅树脂涂覆？ Polyurethane or silicon resin？ 是/Yes ☐ 否/No ■
其它 Others	如有上述信息未包括的，但仍需要注意的事项请注明并附加相应文件。 If vender still has other important informationg for customers，please add the attachment。	

以上表格内容的参考标准：Reference Standard

07.219-2008 元器件认定工艺要求

00409-2009 材料有效储存期

00236-2009 元器件料带贴片工艺要求

IPC J-STD-002C Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires

IEC 60068-2-58 Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to. soldering heat of surface mounting devices (SMD)

EIA-625 Requirement for Handling Electronic-Discharge-Sensitive（ESDS）Devices

IPC-9503 Moisture Sensitivity Classification for Non-IC Components

IPC J-STD-020D Moisture/Reflow Sensitivity Classification of Plastic Surface Mount Devices

<以上所有信息均为 xxx 有限公司所有，不得外传>
All Rights reserved, No Spreading without Permission of xxx